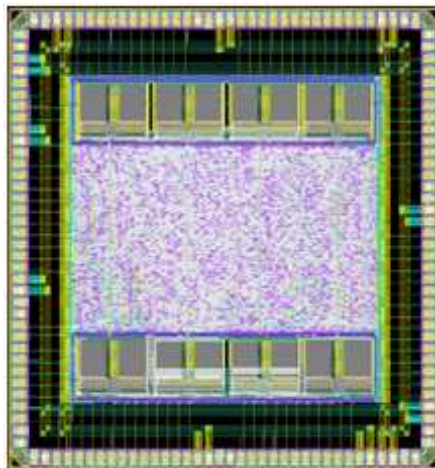


MPW 칩 제작 확인서

폐사는 2013년도 시스템반도체 설계인력양성사업의 “칩설계공동연구 과제와 관련하여 MPW 칩제작을 통해 아래의 코드를 제작하였음을 확인합니다.

1. IP 명 : 깊이 확산을 통한 3차원 깊이 맵 추출 IP
2. 공 정 : TSMC 0.18 μm (3mm \times 3mm)
3. 소 속 : 경북대학교
4. 지도교수 : 문병인
5. 설계자 : 조재욱
6. DB제출 일시 : 2013년 08월 27일
7. 제작 완료 : 2013년 11월 15일
8. 설계도면



(주)에이디테크놀로지 대표이사 김 준 석

